



8440 HS

Tuote Tiedot

Lämpöaktivoituva kalvo sirun kiinnittämiseksi älykorttiin

Tuotteen kuvaus

tesa® HAF 8440 on kaksipuolinen lämpöaktivoitava läpikuultava liimakalvo. Se koostuu termoplastisesta kopolyamidista.

Ominaisuudet

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Good ageing resistance
- Invisible on assembled card

Hakemus

tesa® HAF 8440 on tarkoitettu erityisesti sirujen kiinnittämiseen älykortteihin

- Soveltuu PVC-, ABS- ja PC-kortteihin
- Toimii hyvin kaikilla yleisillä kiinnityslinjoilla
- Kestää ikääntymistä
- Näkymätön korttiin asennettuna

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole | • Suojamateriaalityyppi | silikonipaperi |
| • Liimatyyppi | copolyamidi | • Kokonaispaksuus | 40 µm |

Ominaisuudet

- Kiinnityslujuus 12 N/mm²

Lisätiedot

Tekniset suositukset:

Seuraavat arvot ovat suosituksia aloitusparametreiksi. Huomaa, että ihanteelliset parametrit vaihtelevat koneen tyyppin, korttien ja sirumoduulien materiaalien ja asiakkaan vaatimusten mukaan.

1. Esilaminointi:

Esilaminoinnin aikana teippi laminoidaan moduuliin. Tämä vaihe voidaan tehdä tuotannon aikana tai erikseen.

Esilaminointivaihe ei vaikuta teipin säilyvyyteen. Esilaminoidut moduulit voidaan säilyttää yhtä pitkään kuin teippi.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=08440>



8440 HS

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Koneen asetukset:

- Lämpötila 130 – 140 °C
- Paine 4 - 6 baaria
- Aika 1,5 – 3,0 sek

2. Moduulin kiinnittäminen:

Kun moduuli kiinnitetään, esilaminoidut moduulit stanssataan irti, asetetaan kortin aukkoon ja kiinnitetään paikalleen pysyvästi kuumentamalla. Tarkka menetelmä määräytyy sen mukaan, millaista tuotantolinjaa käytetään. Seuraavat ovat kaksi yleisintä menetelmää:

Yksivaiheinen prosessi, koneen asetukset (alhainen lämpötila):

- Lämpötila¹ 160 – 190 °C
- Paine 65 N/moduuli
- Aika 2,0 – 4,0 sek

Yksivaiheinen prosessi, koneen asetukset (korkea lämpötila):

- Lämpötila¹ 180 – 210 °C
- Paine 65 N/moduuli
- Aika 1,0 – 1,5 sek

Monivaiheinen prosessi (vähintään 2 lämmityspuristusta), koneen asetukset :

- Lämpötila¹ 180 – 200 °C
- Paine 65 N/moduuli
- Aika (kussakin vaiheessa) 0,7 - 1,2 sek

¹Lämpötila mitattuna puristusvaiheen aikana

Varastointiaika määräytyy tesa® HAF -käyttökohteen mukaan.

Huomautus: Sidoksen vahvuusarvot on saavutettu vakioituissa laboratorio-olosuhteissa (keskiarvot). Kunkin valmistuserän arvojen taataan asettuvan tietylle alueelle (materiaali: etsattu alumiininäyte, liimaolosuhteet: lämpötila 120 °C; paine 10 baaria, aika 8 min).



8440 HS

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=08440>